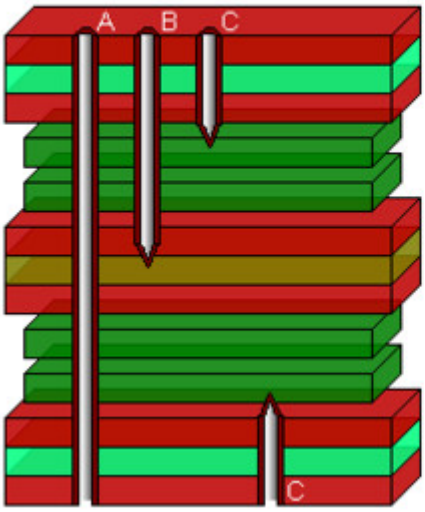
HF-Multilayer 6 Lagen - 1,0 mm (Laminataufbau)

Lagenaufbau

Ebene	Komponente	Dicke (mm)	Cu (my)	Typ
	Cu+galv.Cu		18+25	
1	HF Tr-Lam	0.25		
	Cu		18	
2	FR4 Prepreg	0.048		106
	FR4 Prepreg	0.048		106
	Cu		18	
3	FR4 Tr-Lam	0.20		
	Cu		18	
4	FR4 Prepreg	0.048		106
	FR4 Prepreg	0.048		106
	Cu		18	
5	HF Tr-Lam	0.25		
	Cu+galv.Cu		18+25	
6				



Presslingsdicke *	1,00	+/- 10%
Gesamtdicke inkl. galv. Cu u. Lötstoppmaske *	1,11	+/- 10%

Bemerkungen zum Lagenaufbau:

- * Dickenberechnung bei 50% Kupferbelegung auf Innenlagen (abhängig von Basismaterialtyp, gewählter Kupferdicke und Kupferbelegung abweichende resultierende Isolations- und Enddicken)
- Dickentoleranz Basismaterial +/-10%
- minimale Kupferenddicken gemäß IPC 6012 aktuelle Ausgabe
- Mischaufbau - Verwindung / Wölbung > 0,75% möglich

Designrules zum Lagenaufbau

KSG GmbH
Auerbacher Str. 3-5
09390 Gornsdorf

Tel. +49 (0)3721-266-0
Fax +49 (0)3721-266-175
E-Mail: sales@ksg-pcb.com

HF-Multilayer 6 Lagen - 1,0 mm (Laminataufbau)

Durchgangslöcher [A] (Vias)	End-Ø	≥ 150 µm
	Viapad-Ø	≥ 450 µm
Sacklöcher [B] (mechanical blind Vias)	End-Ø	≥ 400 µm
	Viapad-Ø	≥ 700 µm
Sacklöcher [C] (mechanical blind Vias)	End-Ø	≥ 300 µm
	Viapad-Ø	≥ 600 µm
Leiterbild Außenlagen		
Standard	Leiterbreite bei 18 µm Grundkupfer Leiterabstand bei 18 µm Grundkupfe	≥100 µm ≥ 120 µm
Leiterbild Innenlagen		
Standard	Leiterbreite bei 18 µm Grundkupfer Leiterabstand bei 18 µm Grundkupfer	≥65 µm ≥ 80 µm
	Leiterbreite bei 35 µm Grundkupfer Leiterabstand bei 35 µm Grundkupfer	≥ 85 µm ≥ 100 µm

KSG GmbH
Auerbacher Str. 3-5
09390 Gornsdorf

Tel. +49 (0)3721-266-0
Fax +49 (0)3721-266-175
E-Mail: sales@ksg-pcb.com